

**教育部籌組臺美半導體教育聯盟第二次說明會
議程**

序	時間	內容
1.	14:00-14:10	主席致詞
2.	14:10-14:40	「臺美半導體教育聯盟」執行方式簡報
3.	14:40-15:30	意見交流（Q&A 時間）
4.	15:30	賦歸

臺美半導體教育聯盟執行方式說明

壹、背景說明

- 一、為深化臺美教育合作，115 年 1 月 22 日台美教育倡議第五次高層對話通過「台美教育倡議新三年策略計畫(2026-2028)」，其中「勞動力發展及人才交流(Workforce Development and Talent Exchange)」以 AI 及半導體人才培育為主要合作議題及目標，臺美雙方期透過此策略計畫之推動，共同培育符合雙方企業需求之高科技人才。
- 二、本部於 115 年 1 月赴美參與「台美經濟繁榮對話」並會晤美國國務院相關主管人員，均強調「產業人力發展」為重要政策方向。在全球供應鏈體系持續發展下，臺灣理工、半導體產業影響力日益提升，目前已有 262 家臺灣高科技產業公司於美國設廠，顯示臺美雙邊對理工及半導體人才培育之需求日益殷切。
- 三、為落實臺美關鍵人才培育合作，教育部籌組臺美半導體教育聯盟，推動臺灣與美方大學共同合作進行半導體人才培育及訓練，可包括學位、非學位、課程、移地訓練、工作坊、短期交流等，並可結合產業實習，以提升雙邊人才專業技能。
- 四、為推動以上合作方案，本部前於 115 年 3 月 26 日召開本聯盟籌組第一次說明會，並邀請學校赴美參與 115 年 5 月 27 日於美國奧蘭多舉辦之「臺美半導體高等教育交流會」暨見證「臺美半導體教育聯盟合作意向書」簽署儀式。該合作意向書係由財團法人高等教育國際合作基金會(FICHET)代表本部與美國州立學院及大學協會(AASCU)簽署。目前我方聯盟學校計有 23 校，美方則有 27 所 AASCU 成員學校出席前揭聯盟簽約儀式。

貳、執行方式說明

一、「臺美半導體教育聯盟」參與學校應備條件

- (一) 配合本部 115 年 5 月訪美行程，已有 23 校參與本聯盟，並提出短期研習課程、短期交換培訓計畫、學位研修方案及其他客製化合作

方案，為使聯盟運作機制符合美方人才培育需求，聯盟學校參與條件如下：

1. 必要條件：學校須設有半導體或微電子相關學位學程（學士、碩士或博士），並具備完整之全英語授課（EMI）專業師資陣容及教學能力。
2. 具以下條件者尤佳：
 - (1) 已與國外大學建立半導體相關國際合作模式者優先，包括「2+2」雙聯培育模式、學分銜接（Articulation）機制、學生實習合作等具體經驗。
 - (2) 具備半導體(如 IC 設計、製程、封裝、測試、廠務、材料量測等)或微電子(如 PCB、天線等)之設備與實驗室，若有類產線（Quasi-Production Line）設施者尤佳。
 - (3) 具備優質華語教學資源，包括專業華語師資、教材及長期輔導外國學生學習華語之經驗，以協助外國學生融入在臺學習與生活環境。

二、「臺美半導體教育聯盟」參與學校合作方案及資源盤點

(一) 為利進一步盤點各校半導體人才培育課程及計畫，請學校提供下列資訊：

1. 依合作模式盤點課程及方案類型：
 - (1) 短期研習（Short-term Training）
 - (2) 短期交換（Short-term Exchange）
 - (3) 學位課程（Degree Program）
 - (4) 其他合作或客製化方案（Other Collaborative or Customized Programs）
2. 學校所提供之合作方案需具備以下機制（可擇一或同時具備）
 - (1) 實習機制：
 - A. 能與半導體或微電子相關企業(以已赴美投資或規劃赴美投資之企業為優先)合作，提供美國學生以全英語方式參與暑期、一學期或一學年以上之實習機會。
 - B. 合作企業能提供適當之實習津貼或相關補助。

- (2) 證照培訓機制：能提供以英語授課為主之半導體或微電子相關證照培訓課程（如 iPAS、自強工業基金會等），並搭配相關輔導課程（約 240 小時），協助學生取得專業證照。

3. 國際合作情形

- (1) 已合作之美國大學及合作領域。
 - (2) 已合作之美國企業或在美投資之臺灣企業，及其合作領域。
- (二) 本部將於會後提供學校參與意願調查表及相關表件。請有意願參與本聯盟之學校於 115 年 6 月 26 日（星期五）中午前回復學校盤點資料，以利後續彙整。（附件 2 供參考）

三、「臺美半導體教育聯盟」合作規劃

為提升臺美半導體人才培育合作效益，並促進各校資源整合與分工合作，本聯盟後續將由財團法人高等教育國際合作基金會(FICHET)設立專案辦公室，配置專責人力協助辦理學校與州別之媒合、合作協調及資源整合等相關工作，以提升聯盟運作成效。

臺美半導體教育聯盟 - 臺灣學校基本資料表

Institution Profile for U.S.-Taiwan Semiconductor Education Alliance

*此份表單內容請以中英文呈現

I. 學校基本資料 Basic Information about your university

學校中英文全名			
地址 Address			
郵遞區號及城市 Postal Code & Town			
電話 Telephone		Email	
學校網站 University website			
半導體教育專屬展示網站 Website dedicated for Semiconductor education programs			
學校簡介 A short introduction to your university (200 words ↓)			

II. 臺美半導體產學合作方案 Semiconductor Industry–Academia Collaboration Program with U.S. Higher Education Institutions

短期培訓方案 1：短期研習課程 Short-term Training Programs *如有多項可自行新增欄位，如無請填無	
短期研習課程名稱 Name of the Short-Term Program	
關鍵字 # (可複選)	☐ 半導體課程 ☐ 專業華語課程 ☐ 文化體驗課程 ☐ 企業參訪 ☐ 其他_____
研習期程 Duration	
短期研習課程內容簡述 Brief Overview of the Short-Term Program (中文 200 字↓，英文 300 字↓，含課程期間及合作廠商)	
對象 Target Trainees / High school, college, undergraduate, master's, and doctoral students	

臺美半導體教育聯盟 - 臺灣學校基本資料表

Institution Profile for U.S.-Taiwan Semiconductor Education Alliance

*此份表單內容請以中英文呈現

短期培訓方案 2：短期交換培訓 Short-Term Exchange Program *如有多項可自行新增欄位，如無請填無	
短期研習課程名稱 Name of the Short-Term Program	
關鍵字 # (可複選)	☐ 半導體課程 (☐ 製程 ☐ 封裝 ☐ 測試 ☐ 其他半導體課程_____) ☐ 專業華語課程 ☐ 文化體驗課程 ☐ 企業參訪 ☐ 企業實習 ☐ 專業證照 ☐ 其他_____
研習期程 Duration	_____ 學期
短期交換培訓內容簡述 Brief Overview of the Short-Term Exchange Program (中文 200 字↓，英文 300 字↓，含課程期間及合作廠商)	
對象 Target Trainees / High school, college, undergraduate, master's, and doctoral students	
學位課程方案 Degree Program *如有多項可自行新增欄位，如無請填無	
研修方案名稱 Name of the Professional Development Program	
關鍵字 # (可複選)	☐ 半導體 IC 設計工程師 ☐ 半導體封裝工程師 ☐ 半導體測試工程師 ☐ 半導體廠務工程師 ☐ 半導體工業管理師 ☐ 半導體科技管理師 ☐ 專業華語課程 ☐ 文化體驗課程 ☐ 企業參訪 ☐ 企業實習 ☐ 專業證照 ☐ 其他_____
研修方案簡述 Brief Overview of the Professional Development Program (中文 200 字↓，英文 300 字↓，含招生班別、名額、課程期間及合作廠商)	
招收對象 Target Trainees / High school, college, undergraduate, master's, and doctoral students	
其他合作方案 Other Collaborative Programs *如有多項可自行新增欄位，如無請填無	
方案內容簡述 Overview of the program (中文 200 字↓，英文 300 字↓，含課程期間及合作廠商)	

臺美半導體教育聯盟 - 臺灣學校基本資料表

Institution Profile for U.S.-Taiwan Semiconductor Education Alliance

*此份表單內容請以中英文呈現

關鍵字 # (可複選)	☐ 半導體課程 (☐ 製程 ☐ 封裝 ☒ 測試 ☐ 其他半導體課程_____) ☐ 專業華語課程 ☐ 文化體驗課程 ☒ 企業參訪 ☐ 企業實習 ☐ 專業證照 ☐ 半導體 IC 設計工程師 ☐ 半導體封裝工程師 ☐ 半導體測試工程師 ☐ 半導體廠務工程師 ☐ 半導體工業管理師 ☐ 半導體科技管理師 ☐ 其他_____	
對象 Target Trainees / High school, college, undergraduate, master's, and doctoral students		
學校所提供之合作方案具備之人才培育機制 (可擇一或同時具備) Does the cooperation program offered by your university include any of the following talent development mechanisms? (Please select all that apply.) *如有多項可自行新增欄位，如無請填無		
☐ 實習機制 Internship opportunities		
	☐ 能與半導體或微電子相關企業 (以已赴美投資或規劃赴美投資之企業為優先) 合作，提供美國學生以全英語方式參與暑期、一學期或一學年以上之實習機會 ☐ 合作企業得提供適當之實習津貼。 在臺合作企業名稱：	
☐ 證照培訓機制 Certification training mechanism		
	☐ 能提供以英語授課為主之半導體或微電子相關證照培訓課程 (如 iPAS、自強工業基金會等) ☐ 並能搭配相關輔導課程 (約 240 小時)，協助學生取得專業證照。 若學校能以英文提供 iPAS 培訓，請勾選可培訓之鑑定項目 ☐ 電子通訊類 - 天線設計工程師 ☐ 電子通訊類 - 電路板製程工程師 ☐ 電子通訊類 - 電磁相容工程師 ☐ 電子通訊類 - AIoT 應用工程師 ☐ 資訊類 - 資訊安全工程師 ☐ 資訊類 - 營運智慧分析師 ☐ 智慧機械類 - 3D 列印積層製造工程師 ☐ 智慧機械類 - 工具機機械設計工程師 ☐ 智慧機械類 - 智慧生產工程師 ☐ 綠能科技類 - 塑膠材料應用工程師 ☐ 綠能科技類 - 電動車機電整合工程師 ☐ 跨領域 - AI 應用規劃師	
已經合作半導體相關計畫的美國學校所屬地點 (學校/城市/州別) Current U.S. University Partners in Semiconductor Education (University/ City /State) *如有多項可自行新增欄位，如無請填無		
Univeristy	City	State

臺美半導體教育聯盟 - 臺灣學校基本資料表

Institution Profile for U.S.-Taiwan Semiconductor Education Alliance

*此份表單內容請以中英文呈現

預計合作半導體相關計畫的美國學校所屬地點（學校/城市/州別） Prospective U.S. University Partners in Semiconductor Education (University/ City /State) *如有多項可自行新增欄位，如無請填無		
Univeristy	City	State
已經合作的在美投資之半導體廠商所屬地點（廠商/城市/州別） Current Industry Partners in Semiconductor Education (Company/City/State) *如有多項可自行新增欄位，如無請填無		
Company	City	State
預計合作的在美投資之半導體廠商所屬地點（廠商/城市/州別） Prospective Industry Partners in Semiconductor Education (Company/City/State) *如有多項可自行新增欄位，如無請填無		
Company	City	State
貴校現行半導體教育國際合作亮點案例 Best Practices in Semiconductor Education Cooperation（中文 300 字↓，英文 400 字↓）		
臺美半導體教育聯盟單一聯繫窗口 Contact Information		
姓名 Name		
學校 University		
單位 Department/ Affiliation		
職稱 Position		
Email		
電話 Telephone		

※填表說明：

- (1) 填寫時，建議著重說明計畫與產業之連結，包括企業合作、實務培訓及研究合作等面向。亦鼓勵描述方案於人才培育之預期成效，例如專業技能提升、實務即戰力之養成，以及對半導體人才供應鏈之具體貢獻。
- (2) 此份表單內容請以中英文呈現。
- (3) 請於填妥內容後，本表以 **word 檔** 形式，上傳至貴校雲端資料夾(網址擬於會後提供)
- (4) 敬請於 **6 月 26 日（五）中午 12:00 前** 完成相關資料上傳。

臺美半導體教育聯盟 - 臺灣學校基本資料表
Institution Profile for U.S.-Taiwan Semiconductor Education Alliance

*此份表單內容請以中英文呈現

(5) 如有任何填表問題，敬請聯繫高教基金會

陳專員 Tel.: +886-2-2322-2280 ext. 125 | Email: vivichen@fichet.org.tw /

陳專員 Tel.: +886-2-2322-2280 ext. 126 | Email: ryanc@fichet.org.tw